

参加申込書(締切 6月22日(木))

フリガナ	
お名前	
ご所属(企業、大学、機関等)	
部署・役職	
E-mailアドレス	
電話番号	
交流会へのご参加 (参加費は3,000円です)	参加 ・ 不参加 (いずれかに丸印をおつけ下さい)

ポスターセッション

<p>発表テーマ</p> <p>多孔性配位高分子を用いた新しい高分子素材の開発とガス分離膜への応用</p> <p>京都大学 高等研究院 iCeMS 特定助教 細野 暢彦</p>	<p>発表テーマ</p> <p>Reduction of carbon dioxide using molecular catalysts which simulates bio-enzyme</p> <p>京都大学 高等研究院 iCeMS 特定研究員 GHOSH Debashis</p>	<p>発表テーマ</p> <p>Synthesis of IrCu solid-solution alloy nanoparticles for catalytic applications</p> <p>京都大学 大学院理学研究科 特定研究員 WANG Fenglong</p>	<p>発表テーマ</p> <p>多孔性配位高分子(PCP)触媒によるCO₂の再資源化</p> <p>京都大学 高等研究院 iCeMS 特定研究員 梶原 隆史</p>
<p>発表テーマ</p> <p>循環型固体水素源材料の開発と新展望</p> <p>京都大学 大学院工学研究科 特定研究員 VISBAL Heidi</p>	<p>発表テーマ</p> <p>アンモニア燃料電池及びレドックスフロー電池のための新材料創成</p> <p>同志社大学 理工学部 特定任用研究員 橋之口 道宏</p>	<p>発表テーマ</p> <p>GaNを用いた新しい電力デバイス-PLDを用いたデバイス製作技術-</p> <p>京都工芸繊維大学 グリーンイノベーションセンター 特任教授 上田 大助</p>	<p>アンケートのご協力お願い</p> <p>ご興味のある発表テーマにチェックを入れて下さい。(複数回答可)</p> <p>[例] <input checked="" type="checkbox"/> 発表テーマ</p>

※招へい研究者のプロフィールは、ホームページのシリーズ企画「招へい研究者に聞く!!」で公開中! 「招へい研究者に聞く」

FAX:075-315-3695 Web申込フォーム <http://www.resik.jp/>

個人情報に関する利用目的等を確認し、下記個人情報の取扱に同意した上で、参加を申し込みます。

個人情報の取扱いについて

1.個人情報の利用目的

ご入力いただきました個人情報は当財団で管理させていただき、本事業の運営にかかわる資料の作成、ご連絡、及び今後当財団が主催、共催または後援する催事のご案内に利用させていただきます。

2.個人情報の提供および取扱の委託について

法令に基づく場合を除き第三者に貴殿の個人情報を提供もしくは取扱を委託することはありません。

3.通知、開示、訂正、利用停止、削除をご希望の場合

提供いただきました個人情報に関して、利用目的の通知、開示、訂正、利用停止、削除を希望される場合には、ご利用者本人の要求であることを確認したうえで、所定の手続きにより、合理的な期間および範囲で通知、開示、訂正、利用停止、削除を行います。右記の問い合わせ先へご連絡ください。

【問い合わせ先】

〈事業者の名称〉公益財団法人京都高度技術研究所
〈個人情報保護管理者〉総務部長
〈窓口〉総務部

所在：京都市下京区中堂寺南町134番地
TEL：075-315-3625(代) FAX：075-315-3614
※電話は平日(月～金※祝祭日を除く)9:00～17:00まで。

4.注意事項

ご記入いただく項目に不足がある場合は、本事業への参加をお断りする場合があります。

※財団の個人情報保護方針の詳細は、
<http://www.astem.or.jp/privacypolicy> でご確認ください。